

Pioneering New Breakthroughs in Electronics

DAISHINKU CORP.

2018年3月期第2四半期

決算説明会



株式会社 **大真空**

☆第2四半期末配当を増配

前期実績:1円(併合後基準で5円)→15円

☆世界最小/最薄の新構造水晶デバイス 「Arkh.3Gシリーズ」を開発

☆3年ぶりにCEATEC JAPAN 2017に出展



業績<連結>

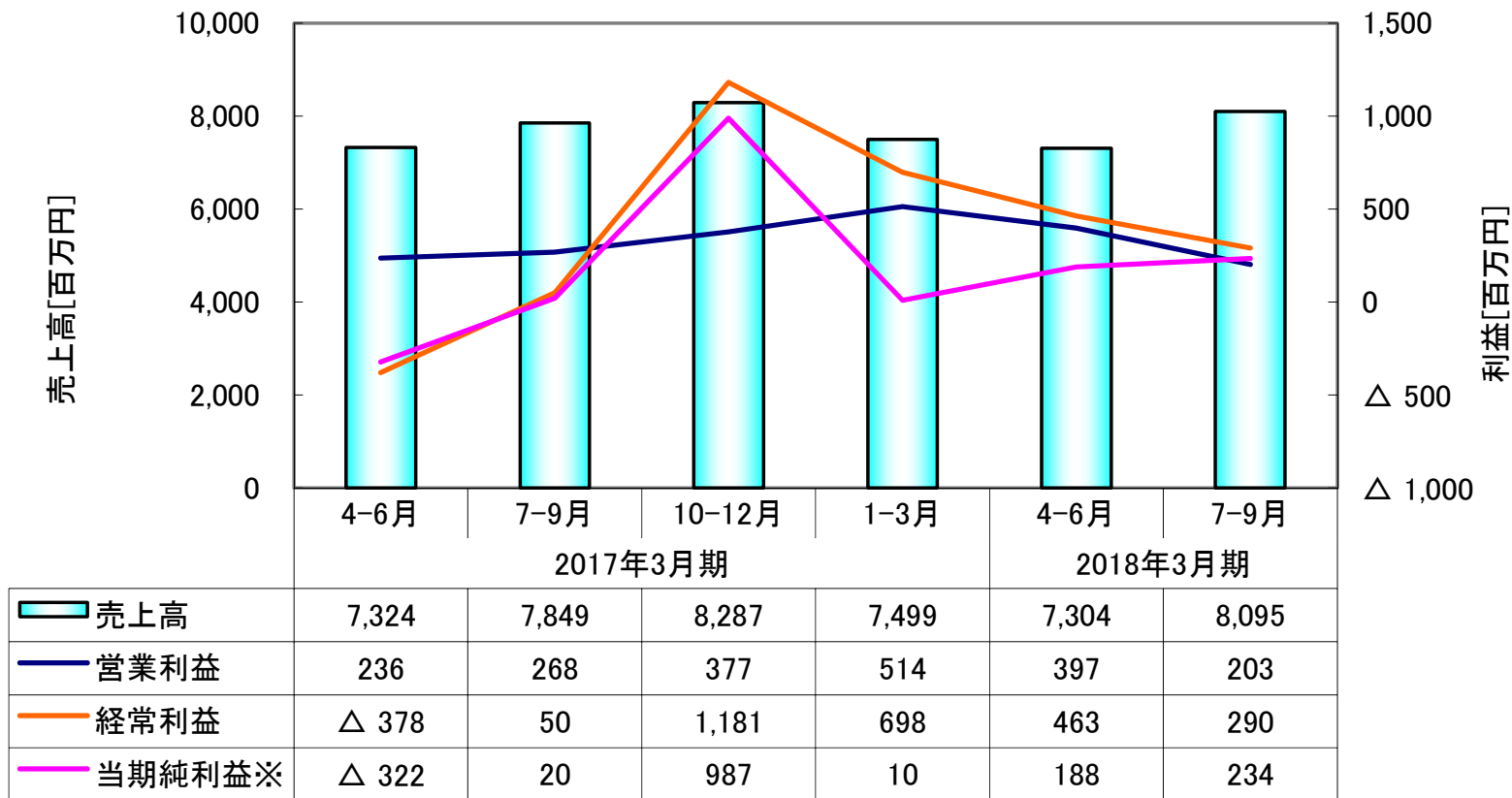
単位:百万円

	2016年9月期	2017年9月期	前年同期比	
			増減	増減率
売上高	15,173	15,399	226 ↑	1.5%
営業利益	504	600	96 ↑	19.0%
経常利益	△ 328	753	1,081 ↑	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	△ 302	422	724 ↑	-
1株当たり 四半期純利益(円)	△ 37.51	52.33	89.84 ↑	-
総資産	56,671	60,787	4,116 ↑	7.3%
純資産	28,098	31,842	3,744 ↑	13.3%
株主資本比率(%)	42.3	44.4	2.1ポイント ↑	-
USD期末レート(円)	101.12	112.73	11.61 ↑	-
USD平均レート(円)	105.20	111.04	5.84 ↑	-

※当社は2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。このため前期実績の1株当たり四半期純利益は、前連結会計年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、算定しております。

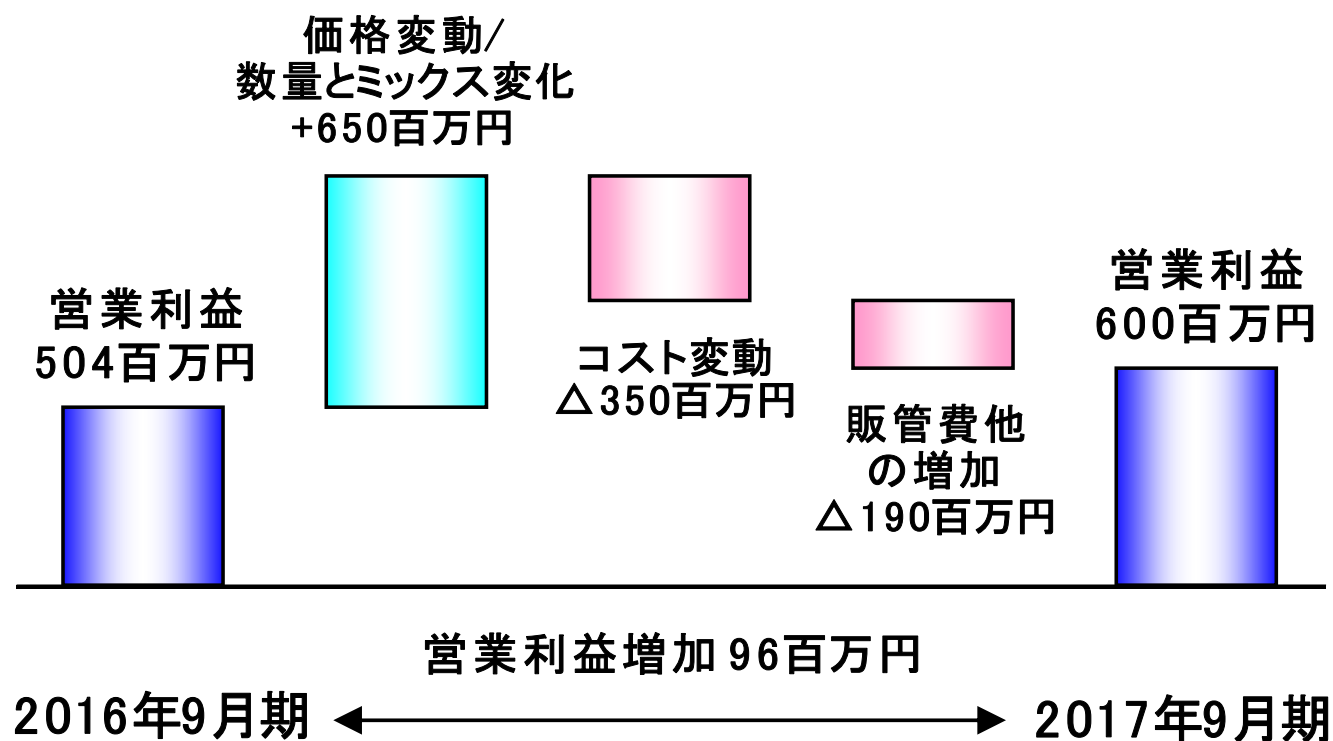


四半期業績<連結>



※親会社株主に帰属する四半期純利益

損益分析<連結>





機種別販売実績<連結>



単位: 百万円

	2016年9月期	2017年9月期	前年同期比
一般水晶振動子	6,406	7,156	12% ↑
音叉型水晶振動子	1,720	1,568	△ 9% ↓
水晶応用製品	6,817	6,259	△ 8% ↓

- ◆ 小型水晶振動子やサーミスタ付水晶振動子の増加により、一般水晶振動子が前年同期比プラス
- ◆ 中国スマホ向けTCXOの減少により、水晶応用製品が前年同期比マイナス



用途別販売実績<連結>

	2016年9月期	2017年9月期	前年同期比
通信	41%	36%	△ 11% ↓
カーエレ	28%	30%	10% ↑
民生	19%	20%	6% ↑
産業	10%	12%	22% ↑
その他	2%	2%	7% ↑

※前年同期比は絶対額の増減率

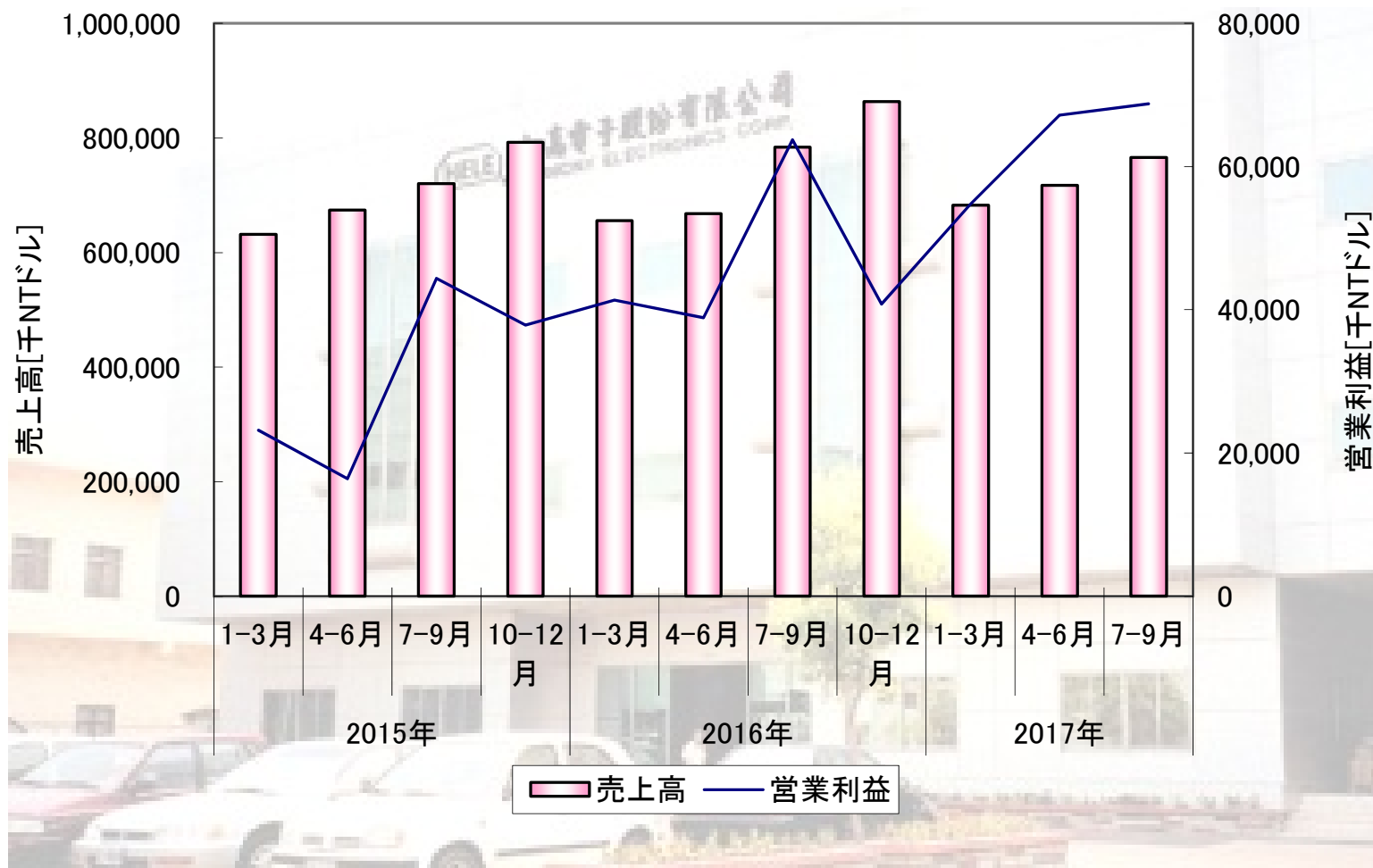
- ◆カーエレ分野、産業分野は堅調に推移し、前年同期比で2桁以上のプラス
- ◆通信分野は中国スマホが立ち上がらず、前年同期比マイナス



地域別販売実績<連結>

	2016年9月期	2017年9月期	前年同期比
日本	16%	19%	17% ↑
アジア	70%	66%	△ 5% ↓
北米	5%	6%	5% ↑
欧州	8%	10%	21% ↑
※前年同期比は絶対額の増減率			
海外売上比率	84%	81%	△3ポイント ↓
海外生産比率	47%	54%	7ポイント ↑

◆ 中国スマホが立ち上がらず、アジアでの販売が前年同期比マイナス



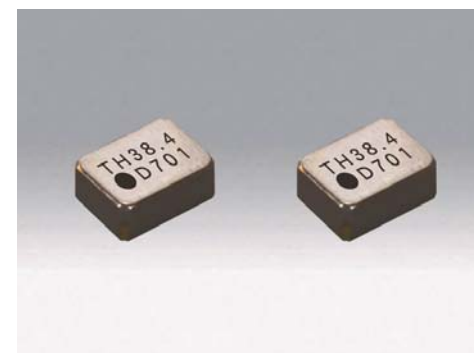


設備投資・減価償却費 研究開発費<連結>

単位：百万円

	2016年9月期	2017年9月期	増減
設備投資	1,535	1,898	363 ↑
減価償却費	1,252	1,352	100 ↑
研究開発費	828	845	17 ↑

◆ 小型水晶振動子やサーミスタ付水晶振動子を中心に能力増強





業績予想<連結>

単位：百万円

	上半期実績	2018年3月期 通期計画
売上高	15,399	34,000
営業利益	600	1,440
経常利益	753	1,440
親会社株主に 帰属する当期純利益	422	740
1株当たり配当金	15円	-
USD平均レート(円)	111.04	110.00
設備投資	1,898	3,500
減価償却費	1,352	2,800
研究開発費	845	1,800

☆ 小型水晶振動子、Arkh.3Gシリーズの
設備立ち上げ

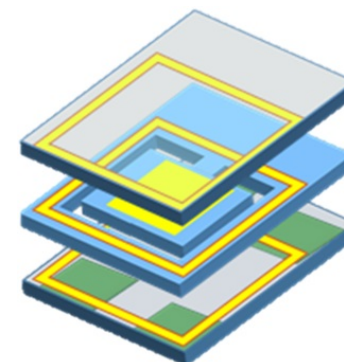
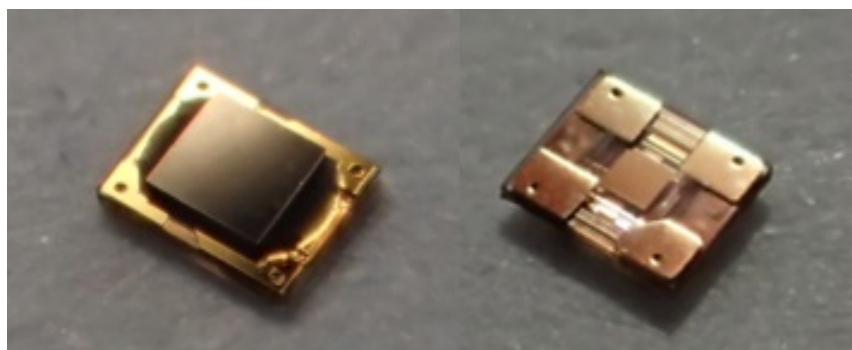


☆ 販売強化

☆ 天津大真空の採算改善に注力



〈Arkh.3Gシリーズ〉



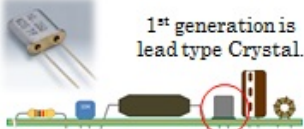
★ 世界最小/最薄を実現(11/27現在 当社調べ)

機種名	サイズ(mm)	厚み(mm max.)
DX1008J(水晶振動子)	1.0×0.8	0.15
DS1008J(SPXO)		0.26
DA/DB1008J(TCXO)		

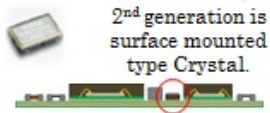
★ 水晶の加工技術と気密封止技術を融合した
全く新しいタイプの超小型/超薄型水晶デバイス

Changes in packaging technology

1G : Lead type

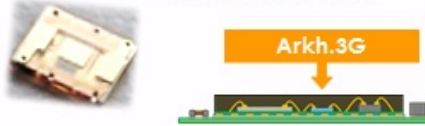


2G : SMD



3G : Embedded type

3rd generation is Embedded Crystal in IC package.



超薄型設計により、SiPモジュールなどへの内蔵も可能

WLPにより高信頼性を実現し、車載用途にも貢献

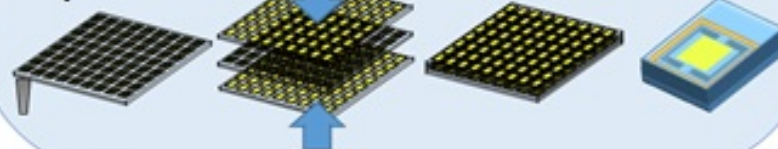
Photolithography process

External shape formation → Electrode formation



Process in vacuum

Frequency adjustment → Sealing → Complete





展示会への出展



3年ぶりにCEATEC JAPAN 2017に出展

トリプルエスクリスタル、
Arkh.3Gシリーズ、
MEMS発振器などを展示




第19回電子部品・材料EXPOに出展

会期: 2018年1月17日(水)~19日(金)

会場: 東京ビッグサイト



A horizontal decorative bar consisting of a solid blue segment on the left, followed by a series of rectangular segments of varying lengths and shades of blue, transitioning from dark to light from left to right.

今期の業績などの予想につきましては、現時点
で得られた情報に基づき算出していますが、不
確定な要素を含んでおります。業況の変化など
により、業績予想とは違った結果になりうるこ
とをご承知おきください。